

UEFI 設定公用程式

1 簡介

ASRock 互動式 UEFI 是一套混合系統設定工具、酷炫音效與絕妙視覺效果的程式。此套程式不僅能讓 BIOS 設定變得毫無難度，且更加有趣。本章節說明使用 UEFI 設定公用程式設定您系統的方式。您可在開啟電腦電源後立即按下 <F2> 或 執行 UEFI 設定公用程式，否則開機自我測試 (POST) 將繼續原本的測試常式。若您想要在 POST 後進入 UEFI 設定公用程式，請按下 <Ctl> + <Alt> + <Delete>，或按下系統機殼上的重設按鈕重新啟動系統。您也可先關閉系統電源，再重新開啟而重新啟動。



因為 UEFI 軟體會持續更新，所以下列 UEFI 設定畫面及說明僅供參考，可能會與您在畫面上看到的不完全相同。

1.1 UEFI 功能表列

在畫面最上方的功能表列共有下列選項：

主要	適用於設定系統時間／日期資訊
OC Tweaker	適用於超頻設定
進階	適用於進階系統設定
工具	實用工具
硬體監視器	顯示目前的硬體狀態
開機	適用於設定開機設定及開機優先順序
安全性	適用於安全性設定
結束	結束目前畫面或 UEFI 設定公用程式

1.2 導覽鍵

使用 <←> 鍵或 <→> 鍵選擇功能表列上的選項，再使用 <↑> 鍵或 <↓> 鍵上下移動游標選擇項目，然後按下 <Enter> 進入子畫面。您也可以使用滑鼠點選您所需的項目。

請核對下表，確認各導覽鍵的說明。

導覽鍵	說明
+ / -	變更選取項目的選項
<Tab>	切換至下一個功能
<PGUP>	前往上一頁
<PGDN>	前往下一頁
<HOME>	前往畫面最上方
<END>	前往畫面最下方
<F1>	顯示一般說明畫面
<F4>	開啟／關閉聲音
<F7>	捨棄變更並結束設定公用程式
<F9>	在所有設定中，載入最佳預設設定值
<F10>	儲存變更並結束設定公用程式
<F12>	列印畫面
<ESC>	跳至結束畫面或結束目前的畫面

2 主畫面

當您進入 UEFI 設定公用程式時，主畫面將出現並顯示系統一覽。

H81M-HG4



進入使用中頁面

進入 UEFI 設定公用程式時，選擇預設頁面。

UEFI 指南

UEFI 指南為適用於 ASRock UEFI 設定公用程式的快速教學課程。您可按下「ESC」中止教學課程。

H81M-DG4



H81M-VG4



3 OC Tweaker 畫面

在 OC Tweaker 畫面中，您可設定超頻功能。



因為 UEFI 軟體會持續更新，所以下列 UEFI 設定畫面及說明僅供參考，可能會與您在畫面上看到的不完全相同。

進階 Turbo 30

您可使用此選項提高系統效能。此選項唯有在 CPU 支援此功能時出現。此選項只有在採用 K 系列 CPU 時出現。

Non-Z OC

Non-Z OC 功能可讓使用者以非 Z87 晶片組主機板將 K 系列 Haswell 處理器超頻。

載入最佳化 CPU OC 設定

您可使用此選項載入最佳化 CPU 超頻設定。請注意，超頻可能會造成 CPU 及主機板損壞。您應自行負擔超頻風險及成本。此選項只有在採用 K 系列 CPU 時出現。

CPU 設定

CPU 快取率

CPU 內部匯流排速率。最大值應與 CPU 倍頻相同。

CPU OC 固定模式

CPU OC 固定模式可讓您持續使用最大 CPU 倍頻設定，而無須節流。請注意，超頻可能會造成 CPU 及主機板損壞。您應自行負擔超頻風險及成本。

CPU 倍頻

CPU 速度是由 CPU 倍頻乘以 BCLK 決定。增加 CPU 倍頻將增加內部 CPU 時脈速度，但不會影響其他元件的時脈速度。

Intel SpeedStep Technology

Intel SpeedStep 技術允許處理器在多項頻率及電壓點之間切換，以獲得最佳省電及散熱效率。

Intel 渦輪加速模式 (Turbo Boost) 技術

操作系統要求最高效能狀態時，Intel 渦輪加速模式 (Turbo Boost) 技術可讓處理器以基本頻率以上執行。

過濾 PLL 頻率

CPU BCLK 過濾頻率。選擇 1.6 作為較佳的超頻功能。

內部 PLL 過電壓

啟用超頻時可獲得更佳穩定性。

PCIE PLL 選擇

選擇超頻時的 SB PLL。

長時間功耗限制

以瓦特為單位設定封裝功耗限制 1。超出限制時，CPU 倍頻在經過一段時間後將變低。下限可保護 CPU 並節省功率，而上限則可改善效能。

長時間持續時間

設定超出長時間功耗限制時，直到 CPU 倍頻變低的時間長度。

短時間功耗限制

以瓦特為單位設定封裝功耗限制 2。超出限制時，CPU 倍頻將立即變低。下限可保護 CPU 並節省功率，而上限則可改善效能。

第一平台電流限制

設定在 Turbo 模式下的 CPU 電流限制，以安培為單位。下限可保護 CPU 並節省功率，而上限則可改善效能。

GT 頻率

設定整合式 GPU 的頻率。

GT 電壓模式

自動：自動取得最佳設定。

彈性：系統為重度負載時，將在整合式 GPU 上增加電壓。

覆寫：電壓為固定。

GT 彈性電壓

設定在整合式 GPU 上增加的固定電壓。

GT 電壓偏移

設定系統為重度負載時，在整合式 GPU 上增加的電壓。

DRAM 時脈設定

載入 XMP 設定

載入 XMP 設定以超頻 DDR3 記憶體，並以超出標準的規格執行。

DRAM 頻率

若選擇 [Auto] (自動)，主機板將偵測記憶體模組是否插入，並自動指派適合的頻率。

DRAM 設定



CAS# 延遲 (tCL)

傳送行位址至記憶體與資料開始回應之間的時間。

RAS# 至 CAS# 延遲 (tRCD)

在開啟記憶體列及存取記憶體行之間所需的時脈週期數。

列預充電延遲 (tRP)

在發佈預充電命令及下一列開啟之間所需的時脈週期。

RAS# 啟用時間 (tRAS)

在 bank active 命令與發佈預充電命令之間所需的時脈週期。

命令速率 (CR)

在選取記憶體晶片時以及可發佈首次啟動命令時之間的延遲。

寫入恢復時間 (tWR)

在可預充電 active bank 之前，完成有效寫入作業後必須經過的延遲時間。

重新整理循環時間 (tRFC)

從 Refresh (重新整理) 命令直到發佈第一個 Activate (啟動) 命令至相同次序的時脈數。

RAS 至 RAS 延遲 (tRRD)

在相同次序不同組別中啟動的兩列間時脈數。

寫入到讀取延遲 (tWTR)

在相同內部組別中的上次有效寫入作業及下次讀取命令之間的時脈數。

讀取到預充電 (tRTP)

在相同次序中，於讀取命令至列預充電命令之間插入的時脈數。

四啟動視窗 (tFAW)

在相同次序中允許的四個啟動時間視窗。

CAS 寫入延遲 (tCWL)

設定 CAS 寫入延遲。

tREFI

以平均週期間隔設定重新整理週期。

tCKE

設定 DDR3 一進入自我重新整理模式後，在內部啟動最少單一重新整理命令的時間長度。

tRDRD

在模組讀取至讀取延遲之間設定。

tRDRDDR

在不同次序中的模組讀取至讀取延遲之間設定。

tRDRDDD

使用此參數可變更 DRAM tRWSR 自動／手動設定。預設值為 [自動]。

tWRRD

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

tWRRDDR

在不同次序中的模組寫入至讀取延遲之間設定。

tWRRDDD

使用此參數可變更 DRAM tRRSR 自動／手動設定。預設值為 [自動]。

在不同 DIMMs 中的模組寫入至讀取延遲之間設定。

tWRWR

在模組寫入至寫入延遲之間設定。

tWRWRDR

在不同次序中的模組寫入至寫入延遲之間設定。

tWRWRDD

在不同 DIMMs 中的模組寫入至寫入延遲之間設定。

tRDWR

在模組讀取至寫入延遲之間設定。

tRDWRDR

在不同次序中的模組讀取至寫入延遲之間設定。

tRDWRDD

在不同 DIMMs 中的模組讀取至寫入延遲之間設定。

RTL (CHA)

設定通道 A 的往返延遲。

RTL (CHB)

設定通道 B 的往返延遲。

IO-L (CHA)

設定通道 A 的 IO 延遲。

IO-L (CHB)

設定通道 B 的 IO 延遲。

ODT WR (CHA)

設定通道 A 記憶體終端電阻的 WR。

ODT WR (CHB)

設定通道 B 記憶體終端電阻的 WR。

ODT NOM (CHA)

使用此參數可變更 ODT (CHA) 自動／手動設定。預設值為 [自動]。

ODT NOM (CHB)

使用此參數可變更 ODT (CHB) 自動／手動設定。預設值為 [自動]。

命令三態

可節省 DRAM 電力。

MRC 快速開機

啟用 Memory Fast Boot (記憶體快速開機) 跳過 DRAM 記憶訓練, 讓開機更快速。

FIVR 設定

FIVR 切換頻率簽章

選擇是否提高或降低 FIVR 切換頻率。

FIVR 切換頻率偏移

設定頻率增加或扣除的百分比。

CPU Vcore 電壓模式

自動：自動取得最佳設定。

覆寫：電壓為固定。

Vcore 覆寫電壓

設定系統為重度負載時，在 Vcore 上增加的電壓。

Vcore 電壓其他偏移

設定加入 Vcore 的動態 Vcore 電壓。

CPU 快取電壓模式

自動：自動取得最佳設定。

覆寫：電壓為固定。

CPU 快取覆寫電壓

系統為重度負載時，將在 CPU 快取上增加電壓。

CPU 快取電壓偏移

設定 CPU 快取的電壓。設定電壓偏高可增加超頻時系統的穩定性。

系統代理程式電壓偏移

設定系統代理程式的電壓。設定電壓偏高可增加超頻時系統的穩定性。

CPU 類比 IO 電壓偏移

CPU I/O 類比電壓。

CPU 數位 IO 電壓偏移

CPU I/O 數位電壓。

CPU 整合式 VR 故障

停用 FIVR 故障會提高閾值觸發 CPU 過電流防護及過電壓防護，並獲得更佳的超頻功能。

CPU 整合式 VR 效率模式

啟用 FIVR Efficiency Management (FIVR 效率管理) 維持省電。停用此項目可獲得更佳的效能及超頻功能。

電壓設定

省電模式

啟用省電模式降低耗電量。

DRAM 電壓

使用此參數可設定 DRAM 電壓。預設值為 [自動]。

PCH 1.05V 電壓

晶片組 1.05V 電壓。使用預設設定值即可獲得最佳效能。

PCH 1.5V 電壓

I/O 1.5V 電壓。使用預設設定值即可獲得最佳效能。

4 進階畫面

在此章節中，您可以設定下列項目：CPU 設定、晶片組設定、儲存裝置設定、Intel® Smart Connect Technology、Super IO 設定、ACPI 設定、USB 設定及可信賴運算。



在此部分中，設定錯誤數值會造成系統故障。

4.1 CPU 設定



現用處理器核心

選擇要在各處理器封裝中啟用的核心數。

CPU C 狀態支援

啟用 CPU C States Support (CPU C 狀態支援) 維持省電。建議維持啟用 C3、C6 及 C7，獲得最佳的省電效率。

增強暫停時態 (C1E)

啟用 Enhanced Halt State (C1E) (增強暫停時態 (C1E)) 降低耗電量。

CPU C3 狀態支援

啟用 C3 睡眠狀態降低耗電量。

CPU C6 狀態支援

啟用 C6 深度睡眠狀態降低耗電量。

CPU C7 狀態支援

啟用 C7 深度睡眠狀態降低耗電量。

封裝 C 狀態支援

啟用 CPU、PCIe、記憶體、顯示卡 C 狀態支援維持省電。

CPU 溫度控制

啟用 CPU 內部溫度控制機制，防止 CPU 過熱。

不執行記憶體保護

採用不執行記憶體保護技術的處理器，可防止特定級別的惡意緩衝區溢位攻擊。

Intel 虛擬化技術

Intel 虛擬化技術允許平台在獨立磁碟分割中執行多個作業系統及應用程式，使單一電腦系統可像多部虛擬系統一樣使用。

硬體預擷取

自動預擷取處理器的資料及代碼。啟用可獲得更佳效能。

鄰近快取線預擷取

擷取目前要求的快取線時，自動預擷取後續快取線。啟用可獲得更佳效能。

4.2 晶片組設定



主要顯示卡

選擇主要 VGA。

VT-d

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O 可協助您的虛擬電腦監視器改善應用程式相容性及可靠性，提升硬體的使用效率，並提供進一步的管理能力、安全性、隔離及 I/O 效能。

PCI-E 連結速度

選擇 PCI-E 的連結速度。

共用記憶體

設定系統開機時配置在整合式圖形處理器的記憶體大小。

IGPU 多重監控

在安裝外部顯示卡後，選擇停用可停用整合式圖形。選擇啟用可保持整合式圖形隨時啟用。

轉譯待機

GPU 為閒置狀態時關閉轉譯器電源，以降低耗電量。

板載 HD 音訊

啟用／停用板載 HD 音訊。設為「Auto (自動)」即可啟用板載 HD 音訊，而安裝音效卡後將自動停用。

前面板

啟用／停用前面板 HD 音訊。

板載 HDMI HD 音訊 (僅適用於 H81M-HG4/H81M-DG4)

啟用板載數位輸出的音訊。

板載 LAN

啟用或停用板載網路介面控制器。

深沈睡眠

設定深沈睡眠模式，在電腦關閉時節省電源。

還原 AC/ 功率損耗

選擇停電後的電源狀態。若選擇 [Power Off (關閉電源)]，電源將在恢復電力後維持關閉。若選擇 [Power On (開啟電源)]，系統將在恢復電力時開始開機。

晚安 LED

啟用 Good Night LED (晚安 LED) 後，電源／LAN LED 將在系統開啟時關閉。系統進入待機／休眠模式時，也會自動關閉電源及鍵盤 LED。

4.3 儲存設定



SATA 控制器

啟用／停用 SATA 控制器。

SATA 模式選擇

IDE：可獲得最佳的相容性。

AHCI：支援改善效能的新功能。



AHCI (進階主機控制器介面) 支援 NCQ，且其他新功能會改善 SATA 磁碟效能，但 IDE 模式並沒有這些優勢。

SATA 積極性連結電源管理

SATA 積極性連結電源管理允許 SATA 裝置在無動作期間進入低電源狀態，以便節省電力。僅 AHCI 模式支援此功能。

硬碟 S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T 代表自我監控、分析及報告技術。這是一套供電腦硬碟機偵測及報告各種可靠性指標的監控系統。

4.4 Intel® Smart Connect Technology



Intel® Smart Connect Technology

Intel® Smart Connect Technology 會在您電腦進入睡眠模式時自動更新您的電子郵件及社交網路，如 Twitter、Facebook 等。

4.5 Super IO 設定



序列連接埠

啟用或停用序列連接埠。

序列連接埠位址

選擇序列連接埠的位址。

紅外線連接埠

啟用或停用紅外線連接埠。

平行連接埠

啟用或停用平行連接埠。

變更設定

選擇平行連接埠的位址。

裝置模式

根據您的連接裝置選擇裝置模式。

4.6 ACPI 設定



載入到 RAM

選擇停用 ACPI 載入類型 S1。建議選擇自動，節省 ACPI S3 的電力。

檢查就緒位元

啟用即可在硬碟就緒 S3 後進入作業系統，建議啟用以獲得較佳的系統穩定性。

ACPI HPET 表

啟用高精度事件計時器 (HPET) 可獲得更佳效能並通過 WHQL 測試。

PS/2 鍵盤電源開啟

允許由 PS/2 鍵盤喚醒系統。

PCIe 裝置電源開啟

允許由 PCIe 裝置喚醒系統及啟用網路喚醒。

來電鈴聲開機

允許由板載 COM 連接埠數據機的來電鈴聲訊號喚醒系統。

定時開機

允許由真實時間鬧鈴喚醒系統。設為「By OS」即可由您的作業系統操控。

USB 鍵盤／遙控開機

允許由 USB 鍵盤或遙控器喚醒系統。

USB 滑鼠開機

允許由 USB 滑鼠喚醒系統。

4.7 USB 設定



USB 控制器

啟用或停用所有 USB 2.0 連接埠。

Intel USB 3.0 模式

啟用或停用所有 USB 3.0 連接埠。

舊型 USB 支援

啟用或停用 USB 2.0 裝置的舊型作業系統支援。若您有 USB 相容性問題，建議停用舊型 USB 支援。請僅在 UEFI 設定及 Windows/Linux 作業系統下，選擇 UEFI 設定以支援 USB 裝置。

舊型 USB 3.0 支援

啟用或停用 USB 3.0 裝置的舊型作業系統支援。

4.8 可信賴運算



安全性裝置支援

啟用即可為您的硬碟機啟動信賴平台模組 (TPM) 安全防護。

5 工具



UEFI 技術服務

若您的電腦有問題，請聯絡 ASRock 技術服務。在使用 UEFI 技術服務之前，請設定網路組態。

簡易驅動安裝程式

簡易驅動安裝程式為 UEFI 內便利的工具，會以 USB 儲存裝置將 LAN 驅動程式安裝於系統，然後自動下載及安裝其他所需的驅動程式，因此適用於無光碟機可從支援光碟安裝驅動程式的使用者之用。

Instant Flash

將 UEFI 檔案儲存在 USB 儲存裝置中，然後執行 Instant Flash 更新您的 UEFI。

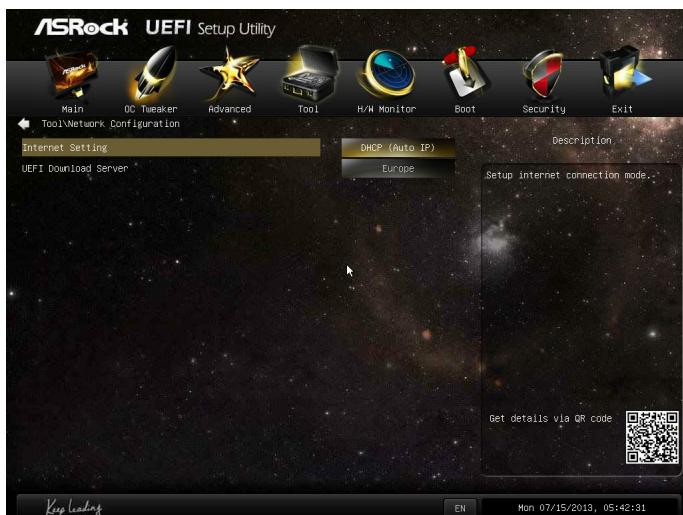
Internet Flash

ASRock Internet Flash 會從伺服器下載及更新最新的 UEFI 韌體版本。在使用 Internet Flash 之前，請設定網路組態。

* 如需 BIOS 備份及復原，建議在使用此功能前插入您的 USB 隨身碟。

網路設定

設定 Internet Flash 的網際網路連線設定。



網際網路設定

啟用或停用設定公用程式中的音效。

UEFI 下載伺服器

選擇下載 UEFI 韌體的伺服器。

除濕機功能

若啟用 Dehumidifier Function (除濕機功能)，電腦將在進入 S4/S5 狀態後自動開機為系統除濕。

除濕時段

設定電腦開機並進入 S4/S5 狀態後啟用 Dehumidifier (除濕機) 的時段。

除濕機時間長度

設定電腦返回 S4/S5 狀態之前的除濕程序時間長度。

除濕機 CPU 風扇設定

設定啟用 Dehumidifier (除濕機) 時的 CPU 風扇速度。數值越高，風扇速度越快。

最大值：255

最小值：1

儲存使用者預設值

鍵入設定檔名稱，然後按 **Enter** 將您的設定儲存為使用者預設值。

載入使用者預設值

載入先前儲存的使用者預設值。

6 硬體狀態監控畫面

本章節提供您監控系統硬體狀態的資訊，其中包括 CPU 溫度、主機板溫度、風扇速度及電壓參數。



CPU 風扇 1 設定

選擇適用 CPU 風扇 1 的風扇模式，或選擇 **Customize** (自訂) 設定 5 CPU 溫度，並為各溫度指定個別風扇速度。

機殼風扇 1 設定

選擇適用機殼風扇 1 的風扇模式，或選擇 **Customize** (自訂) 設定 5 CPU 溫度，並為各溫度指定個別風扇速度。

溫度過熱保護

啟用 **Over Temperature Protection** (溫度過熱保護) 後，系統會自動在主機板過熱時關機。

機殼開啟功能

啟用或停用 **Case Open Feature** (機殼開啟功能) 可偵測機殼蓋是否已取下。

7 開機畫面

本章節顯示系統上供您設定開機設定與開機優先順序的可用裝置。



快速開機

快速開機可將電腦的開機時間降至最短。在快速模式中，您無法從 USB 儲存裝置開機。僅 Windows 8 支援 Ultra Fast (超快速) 模式，且若您使用外部顯示卡，VBIOS 必須支援 UEFI GOP。請注意，由於 Ultra Fast (超快速) 模式的開機速度極快，所以進入本 UEFI 設定公用程式的唯一方式為清除 CMOS 或在 Windows 中執行 UEFI 公用程式重新啟動。

從板載 LAN 開機

允許由板載 LAN 喚醒系統。

設定提示逾時

設定等待設定熱鍵的秒數。

開機後的數字鎖定鍵狀態

選擇系統開機時，Num Lock 是否應開啟或關閉。

開機嗶聲

選擇系統開機時，開機嗶聲是否應開啟或關閉。請注意，需配備蜂鳴器。

全螢幕標誌

啟用可顯示開機標誌，或者停用可顯示正常 POST 訊息。

附件軟體顯示

若已啟用 Full Screen Logo (全螢幕標誌)，啟用 AddOn ROM Display (附件軟體顯示) 可查看 AddOn ROM 訊息或設定 AddOn ROM。停用快速開機速度。

開機失敗恢復

若電腦多次無法開機，系統將自動還原回預設值。

開機失敗恢復計數

設定嘗試開機，直到系統自動還原預設設定值的次數。

CSM (相容性支援模組)



CSM

啟用可啟動相容性支援模組。除非您正在執行 WHCK 測試，否則請勿停用。若您使用 Windows 8 64 位元且所有裝置都支援 UEFI，您也可停用 CSM 以獲得更快的開機速度。

啟動 PXE OpROM 原則

僅選擇 UEFI，執行僅支援 UEFI 選項的 ROM。僅選擇 Legacy（舊型），執行僅支援舊型選項的 ROM。

啟動儲存 OpROM 原則

僅選擇 UEFI，執行僅支援 UEFI 選項的 ROM。僅選擇 Legacy（舊型），執行僅支援舊型選項的 ROM。

啟動視訊 OpROM 原則

僅選擇 UEFI，執行僅支援 UEFI 選項的 ROM。僅選擇 Legacy（舊型），執行僅支援舊型選項的 ROM。

8 安全畫面

在本章節中，您可設定或變更系統的監督員／使用者密碼。您也可清除使用者密碼。



監督員密碼

設定或變更管理員帳戶密碼。只有管理員有權限變更 UEFI 設定公用程式中的設定。在此項目中留白並按下 **Enter** 即可移除密碼。

使用者密碼

設定或變更使用者帳戶密碼。使用者無法在 UEFI 設定公用程式中變更設定。在此項目中留白並按下 **Enter** 即可移除密碼。

安全開機

啟用以支援 Windows 8 安全開機。

9 結束畫面



儲存變更並結束

當您選擇此選項後，將彈出下列訊息：「是否儲存設定變更並結束設定？」選擇 [OK] (確定) 儲存變更並結束 UEFI 設定公用程式。

捨棄變更並結束

當您選擇此選項後，將彈出下列訊息：「是否捨棄變更並結束設定？」選擇 [OK] (確定) 結束 UEFI 設定公用程式，且不儲存任何變更。

捨棄變更

當您選擇此選項後，將彈出下列訊息：「是否捨棄變更？」選擇 [OK] (確定) 捨棄所有變更。

載入 UEFI 預設值

為所有選項載入 UEFI 預設值。此操作可使用 F9 鍵。

在檔案系統裝置中啟動 EFI Shell

將 shellx64.efi 複製到根目錄中，啟動 EFI Shell。